

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



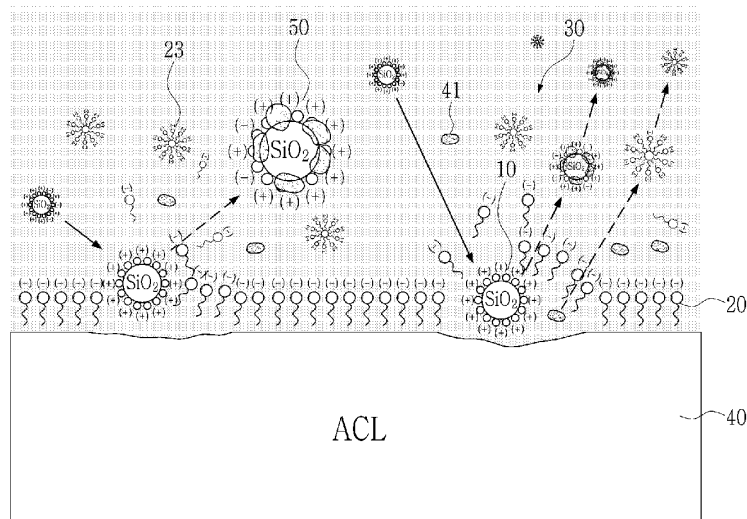
(10) 국제공개번호
WO 2022/260433 A1

2022 년 12 월 15 일 (15.12.2022) **WIPO | PCT**

- (51) 국제특허분류: **C09K 3/14** (2006.01) **H01L 21/304** (2006.01) **Hyun**; 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR).
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/008090 (74) 대리인: 특허법인 천지 (IPCJ PATENT & LAW FIRM); 06224 서울특별시 강남구 논현로76길 24, 2층(역삼동, 신한빌딩), Seoul (KR).
- (22) 국제출원일: 2022 년 6 월 8 일 (08.06.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2021-0074283 2021 년 6 월 8 일 (08.06.2021) KR
- (71) 출원인: 주식회사 동진세미켐 (DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.) [KR/KR]; 22824 인천광역시 서구 백범로 644, Incheon (KR).
- (72) 발명자: 김희석 (KIM, Hee Suk); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 이구화 (LEE, Goo Hwa); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 유재홍 (YOO, Jae Hong); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 박종대 (PARK, Jong Dai); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 김재현 (KIM, Jae Hyun); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,

(54) Title: ORGANIC LAYER POLISHING COMPOSITION AND METHOD FOR POLISHING USING SAME

(54) 발명의 명칭: 유기막 연마 조성물 및 이를 이용한 연마 방법



(57) Abstract: The present invention relates to an organic layer polishing composition and a method for polishing using same. The organic layer polishing composition includes a polishing promoter containing both a hydrophilic group and a hydrophobic group so that even for an organic layer that is strongly bound by covalent bonds, such as an amorphous carbon layer (ACL) or diamond-like-carbon (DLC), as well as a polymer, SOC, and SOH, the polishing rate is maintained high.

(57) 요약서: 본 발명은 친수성기와 소수성기를 모두 포함하고 있는 연마촉진제를 포함하여 폴리머(Polymer), SOC, SOH 뿐만 아니라, 무정형 탄소막(ACL) 또는 DLC(Diamond-Like Carbon)와 같이 공유결합으로 강하게 결합되어 있는 유기막에 대하여도 연마 속도가 높게 유지되는 유기막 연마 조성물 및 이를 이용한 연마 방법에 관한 것이다.

[다음 쪽 계속]



WO 2022/260433 A1

MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수
하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))